18p-P8-5

ベンゾジチオフェンダイマー誘導体の真空蒸着薄膜を用いた 有機トランジスタにおける基板加熱の効果

Effect of substrate heating for organic transistors based on vacuum deposited films of

benzodithiophene-dimer derivative

和歌山大システムエ, 〇福村 光平, 月城 将也,山下 雄大,大須賀 秀次, 宇野 和行,田中 一郎

Wakayama Univ., [°]K. Fukumura, M. Tsukishiro, Y. Yamashita, H. Osuga, K. Uno, and I. Tanaka

E-mail: s133043@sys.wakayama-u.ac.jp

【はじめに】われわれは、大気中安定性に優れ、高キャリア移動度が期待できるベンゾジチオフェン ダイマー(BDT-dimer)誘導体の薄膜を用い、有機薄膜トランジスタ(OTFT)の作製を試みている。今回 は、図1に示した 2C₄-BDT-dimer の真空蒸着薄膜を用いた OTFT における、基板加熱の効果について 報告する。

【実験】 n⁺-Si/SiO₂ 基板上に HMDS 単分子層を成膜した。その上に真空蒸着法を用いて 2C₄-BDT-dimer 薄膜を 60 nm 成膜した。成膜中に基板加熱しなかった場合と基板温度 60 °C、80 °C、100 °C の 4 通り を検討した。最後に、Au 電極をマスク蒸着し、チャネル長 21-68 μ m、チャネル幅 2000 μ m のトップ コンタクト型の OTFT を作製した。薄膜の評価には原子間力顕微鏡(AFM)と X 線回折(XRD)装置を用 い、OTFT の特性は半導体パラメーターアナライザーを用いて測定した。

【結果及び考察】図 2(a)に基板温度 80 ℃ で成膜した薄膜表面の AFM 像を、図 2(b)にℓ-ℓ'に沿った 断面プロファイルをそれぞれ示す。AFM 像にはステップ&テラス構造が観察され、ステップの高さは 2.9±0.2 nm であった。図 3 に Out-of-plane XRD による測定結果を示す。20 = 3.40°に一次の回折ピー クがみられ、それ以外は高次の回折ピークである。また、この回折ピークから算出した結晶面間隔は 2.60 nm であり、AFM で観測したステップの高さにほぼ一致する。ゆえに、AFM により観測された ステップは結晶構造を反映したステップであると考えられる。表1 に各基板温度で蒸着した薄膜を用 いて作製した OTFT のキャリア移動度と on/off 比をまとめ、図4 に 80 ℃ の場合の出力特性を示す。 基板温度を高くするにつれてキャリア移動度は向上し、80 ℃ の場合に最大キャリア移動度 1.8 cm²V¹s⁻¹が得られたが、100 ℃ の場合にはキャリア移動度が低下した。基板温度 100 ℃ で蒸着した膜 の AFM 像では全体的にテラス幅が広くなったことが観察されたが、ところどころにクラックが生じ ていることもわかった。キャリア移動度が低下した原因は、このクラックによるものと考えられる。



Fig. 1. Structure of 2C₄-BDT-dimer.



Fig. 2. (a) AFM image of the 2C₄-BDT-dimer film deposited at 80 °C and (b) cross-sectional profile along the line $\ell - \ell'$.



Substrate temperature(°C

without heating

60

80

Fig. 3. Out-of-plane XRD pattern of the $2C_4\mbox{-}BDT\mbox{-}dimer$ film deposited at 80 $^\circ\mbox{C}$.



On/off ratio

10⁶

10⁶

Table 1. Carrier mobility and on/off ratio of the OTFTs fabricated with the 2C₄-BDT-dimer films deposited at various substrate temperatures.

Maximum

0.33

1.6

Carrier mobility (cm²V⁻¹s⁻¹

Average

 0.25 ± 0.07

 1.3 ± 0.2

Fig. 4. Output characteristics of the OTFT fabricated with the $2C_4$ -BDT-dimer film deposited at 80 °C.